



COMUNICATO STAMPA

SECO rafforza la collaborazione con Qualcomm a Embedded World 2025 per offrire soluzioni industriali all'avanguardia

Arezzo, Italia, 6 marzo 2025 – **SECO**, leader globale in soluzioni end-to-end per l'**embedded computing**, annuncia l'**ampliamento della sua collaborazione tecnologica con Qualcomm Technologies, Inc.** Questa collaborazione rafforza ulteriormente l'impegno di **SECO** nello sviluppo e nell'offerta di soluzioni industriali innovative, sfruttando i prodotti avanzati **Qualcomm Dragonwing™** e le piattaforme **Snapdragon® X Series**. I risultati di questa collaborazione saranno presentati a **embedded world 2025**, dall'11 al 13 marzo a Norimberga, Germania, dove i visitatori potranno scoprire in prima persona le ultime novità frutto di questa sinergia.

SECO sta ampliando il proprio portfolio di prodotti basati sui processori Dragonwing, offrendo una gamma di soluzioni embedded ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico, pensate per applicazioni industriali.

Nel form factor SMARC, SECO offre **System-on-Modules (SoM) SMARC** basati sui processori Dragonwing **QCS5430** e Dragonwing **QCS6490**: il **SOM-SMARC-QCS6490** e il **SOM-SMARC-QCS5430**. Questi SoM forniscono soluzioni scalabili e ad alte prestazioni, ideali per applicazioni HMI industriali, dispositivi industriali portatili, machine vision e applicazioni basate su intelligenza artificiale.

Per **Single Board Computer (SBC)** e **Applicazioni Personalizzate**, SECO è impegnata nello sviluppo di SBC basate sul processore Dragonwing **IQ-615**, che abilita soluzioni embedded potenti e flessibili per HMI industriali, controller per la robotica, smart vision e applicazioni edge intelligenti. È inoltre in fase di valutazione una variante SoM basata sul Dragonwing **IQ-615**, per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti industriali.

Nel campo delle soluzioni COM Express, SECO sta sviluppando un **Computer-On-Module (COM) COM Express** basato sulle **piattaforme Snapdragon X Series**, offrendo un'elevata Potenza di calcolo, accelerazione AI e un'a capacità di elaborazione ad alta efficienza con supporto per Windows. La soluzione sarà disponibile su tutte le piattaforme **Snapdragon X Elite**, **Snapdragon X Plus** e **Snapdragon X**, garantendo la massima flessibilità per un'ampia gamma di requisiti prestazionali.

Infine, per le **soluzioni AI di nuova generazione**, SECO sta valutando **piattaforme ottimizzate per l'intelligenza artificiale**, basate sui processori Dragonwing **IQ8** e **IQ9 Series**, per applicazioni AI di Clea. Queste piattaforme alimenteranno **SBC AI avanzate** e **soluzioni AI Box**, permettendo ai clienti industriali di integrare **intelligenza artificiale in tempo reale**, **edge computing** e **funzionalità di machine learning** nelle proprie operazioni.

*"SECO è impegnata a offrire soluzioni industriali all'avanguardia e la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies ci permette di portare l'elaborazione ad alte prestazioni abilitata dall'AI direttamente all'edge," ha dichiarato **Davide Catani, Chief Technology Officer di SECO**. "Grazie al nostro portafoglio in continua espansione di soluzioni basate sulle piattaforme Qualcomm e Snapdragon, offriamo ai clienti industriali gli strumenti per sfruttare appieno il potenziale dell'AI, dell'IoT e dell'edge computing."*

*"I progressi nell'intelligenza artificiale stanno aumentando la domanda di soluzioni edge più efficienti e potenti. Siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione tecnologica con SECO, mentre sviluppano nuovi prodotti embedded che sfruttano le capacità avanzate di calcolo e di AI dei nostri processori Dragonwing e Snapdragon, accelerando così l'innovazione nei mercati industriali," ha dichiarato **Enrico Salvatori, SVP e Presidente di Qualcomm Europe, Inc.***



COMUNICATO STAMPA

Le soluzioni di SECO saranno presentate a **embedded world 2025**, sia presso lo stand di SECO che presso quello di Qualcomm Technologies. I visitatori avranno l'opportunità di approfondire le ultime innovazioni nell'**edge computing industriale** e assistere a dimostrazioni dal vivo di un **Voice Command e LLM Technical Assistant**. Questo sistema è in grado di rispondere a domande tecniche basandosi sulla documentazione di diverse schede elettroniche. Utilizza un sistema Retrieval-Augmented Generation (RAG), che combina un LLM con una ricerca semantica in un database vettoriale ottimizzato e personalizzato, derivato dalla documentazione SECO. Gli utenti potranno interagire sia tramite comandi vocali che digitando con la tastiera. Le risposte verranno fornite sia sullo schermo che attraverso il modello Text-to-Speech di SECO, permettendo agli utenti di leggere e ascoltare le risposte.

Per maggiori informazioni, visita il sito web di [SECO](https://www.seco.com) o incontra gli esperti di SECO a **embedded world 2025, Padiglione 1, Stand 320**.



COMUNICATO STAMPA

SECO

SECO (IOT.MI) è un'azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali. L'offerta hardware e software di SECO abilita le realtà B2B ad introdurre edge computing, Internet of Things, data analytics ed intelligenza artificiale nei propri business. La tecnologia di SECO si estende a numerosi campi di applicazione: sono oltre 450 i clienti serviti in settori come il Medicale, l'Automazione Industriale, il Fitness, il Vending, il Trasportation e molti altri. Consentendo di monitorare in modo accurato l'operatività dei dispositivi on-field, le soluzioni SECO contribuiscono alla nascita di modelli di business a minor impatto ambientale grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

Contatti

SECO S.p.A.

Clarence Nahan

Head of Corporate Development & Investor Relations

Tel. +39 0575 26979

investor.relations@seco.com

Snapdragon e i prodotti a marchio Qualcomm sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue affiliate. Qualcomm, Qualcomm Dragonwing e Snapdragon sono marchi o marchi registrati di Qualcomm Incorporated.